

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

0736590004

Status:

Active

Overview:

[hdm](#)

Description:

2.00mm (.079") Pitch HDM® Board-to-Board Backplane Power Module, Vertical, SMC, Power Receptacle, 12 Circuits, Gold (Au) 0.76µm (30µ")

Documents:

[3D Model](#)

[Drawing \(PDF\)](#)

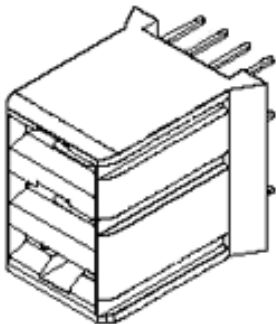
[RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

General

Product Family	Backplane Connectors
Series	73659
Application	Backplane
Comments	Midplane Power Module
Component Type	Power Header
Overview	hdm
Product Name	HDM®
Style	N/A

Physical

Circuits (Loaded)	12
Circuits (maximum)	12
Color - Resin	Black
Durability (mating cycles max)	250
First Mate / Last Break	No
Guide to Mating Part	No
Keying to Mating Part	None
Material - Metal	Beryllium Copper
Material - Plating Mating	Gold
Material - Plating Termination	Tin
Material - Resin	High Temperature Thermoplastic
Number of Columns	1
Number of Pairs	Open Pin Field
Number of Rows	3
Orientation	Vertical
PC Tail Length (in)	0.138 In
PC Tail Length (mm)	3.50 mm
PCB Locator	No
PCB Retention	Yes
PCB Thickness Recommended (in)	0.098 In
PCB Thickness Recommended (mm)	2.50 mm
Packaging Type	Tube
Pitch - Mating Interface (in)	0.079 In
Pitch - Mating Interface (mm)	2.00 mm
Pitch - Term. Interface (in)	0.079 In
Pitch - Term. Interface (mm)	2.00 mm
Plating min: Mating (µin)	30
Plating min: Mating (µm)	0.75
Plating min: Termination (µin)	150
Plating min: Termination (µm)	3.75
Polarized to PCB	No
Stackable	No
Surface Mount Compatible (SMC)	Yes
Temperature Range - Operating	-55°C to +105°C
Termination Interface: Style	Through Hole



Series

image - Reference only

EU RoHS

ELV and RoHS

Compliant

REACH SVHC

Contains SVHC: No

Halogen-Free

Status

Not Reviewed

China RoHS

Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

Search Parts in this Series

73659Series

Mates With

73651 HDM® Board-to-Board Daughterboard Power Module

Electrical

Current - Maximum per Contact	15A
Data Rate	1.0 Gbps
Real Signals (per 25mm)	38
Shielded	Yes
Voltage - Maximum	500V AC

Solder Process Data

Duration at Max. Process Temperature (seconds)	40
Lead-free Process Capability	Reflow Capable (SMT only)
Max. Cycles at Max. Process Temperature	3
Process Temperature max. C	260

Material Info

Reference - Drawing Numbers

Packaging Specification	PK-70873-0819
Sales Drawing	SDA-73659-000*

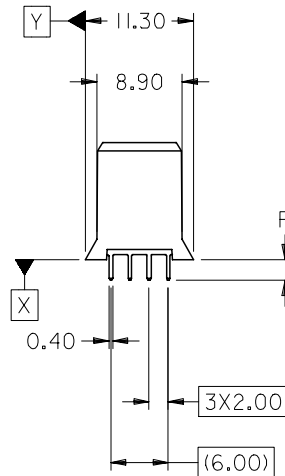
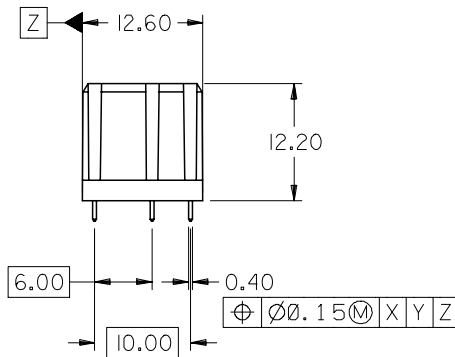
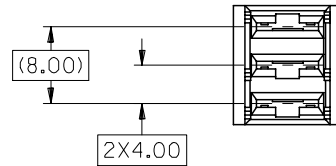
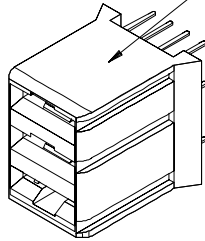
HDM and High Density Metric are trademarks of Amphenol Corporation

This document was generated on 05/14/2010

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

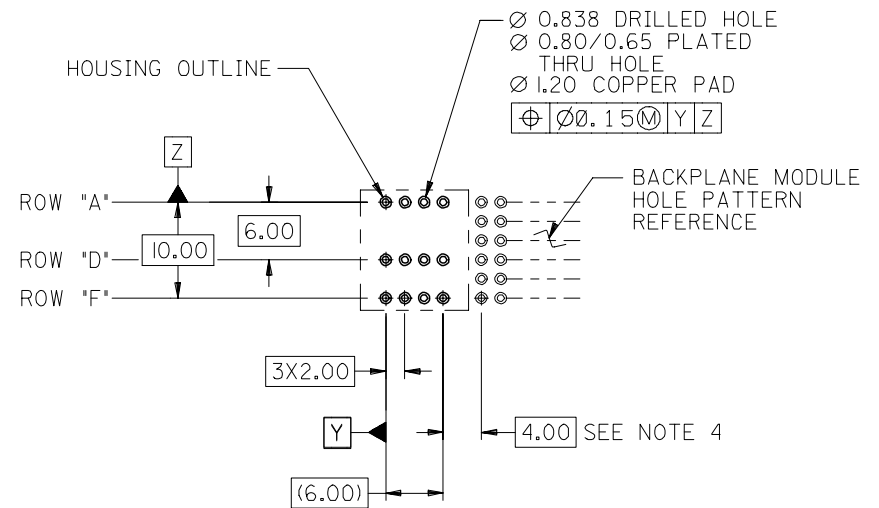
MATERIAL NUMBER	DIM "P" ± 0.25
73659-0001	2.00
73659-0002	2.50
73659-0003	3.00
73659-0004	3.50

DATE CODE AND
PART NUMBER ON
THIS SURFACE OR
SURFACE OPPOSITE.



NOTES:

1. MATERIALS: HOUSING - LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP), GLASS-FILLED, UL94V-0, COLOR: BLACK
TERMINAL - BERYLLIUM COPPER
2. FINISH:
0.75 MICROMETERS MINIMUM SELECTIVE GOLD (Au) IN MATING AREA
2.50 MICROMETERS MINIMUM SELECTIVE TIN (Sn) IN TAIL AREA
NICKEL (Ni) UNDERPLATE OVERALL.
3. THIS PART CONFORMS TO MOLEX PRODUCT SPECIFICATION PS-73670-9999.
4. THIS DIMENSION MUST BE A MULTIPLE OF 4.00mm.
5. DIMENSION ARE IN MILLIMETERS.



PCB LAYOUT: COMPONENT SIDE
RECOMMENDED PCB THICKNESS: 1.57 MIN

MODIFY FINISH EC NO: UCP2007-2259 2007/03/13 DRWN:MSI BARRA 2007/03/21 CHKD:BBARKER 2007/03/22 APPR:SMILLER	QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽=0 DESCRIPTION REV	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 2:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
			mm	INCH	DRAWN BY REED	DATE 1996/12/10	TITLE SALES ASSY HDM BACKPLANE POWER MODULE WITH SOLDER TAILS			
		4 PLACES	± ---	± ---	CHECKED BY	DATE				
		3 PLACES	± ---	± ---	B INGHAM	1996/12/10	MOLEX INCORPORATED			
		2 PLACES	± 0.10	± ---	APPROVED BY	DATE				
		1 PLACE	± 0.25	± ---	B IXLER	1996/12/10	DOCUMENT NO. SDA-73659-000*			
		ANGULAR ±1/2°		MATERIAL NO.		SHEET NO. 1 OF 1				
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SIZE B		SEE TABLE THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION						



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.